

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司终止投资意向书的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资意向书签署概况

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州信越半导体有限公司（以下简称“苏州信越”）及其全体股东于2023年1月3日签署了《投资意向书》，公司拟使用自有资金不超过4,000万元人民币向苏州信越投资。具体内容详见公司于2023年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司签订投资意向书的公告》（公告编码：2023-001）。

### 二、终止投资事项的说明

自《投资意向书》签署后，公司聘请了中介机构对苏州信越进行尽职调查等相关工作，并与相关各方就投资事项进行了商洽，但相关各方未能就本次投资事项达成最终共识，无法签署正式投资协议。为维护公司和广大投资者利益，经审慎研究并与相关各方友好协商，公司决定终止本次投资事项。

### 三、终止本次投资对公司的影响

公司签署的《投资意向书》仅为意向性协议，目前公司未与相关各方签订正式的投资协议，终止本次投资事项不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十日